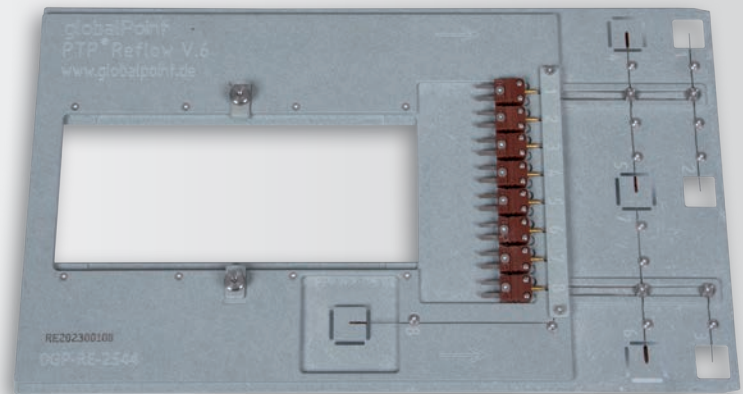
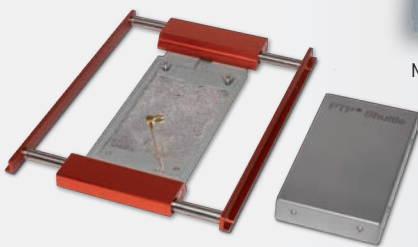




horus®-Elektronik + Software (OGP-ME-V2)



Messboard REFLOW V6 (OGP-RE-2544)



horus® Shuttle, E-Träger und Thermoschutz (OGP-SH002)



➔ REFLOW V6

horus®-Messsystem für Prozesserfassung, -analyse und -optimierung

Mit dem **Messboard REFLOW V6** und der **Messelektronik horus®** steht ein ideales und vielseitiges Instrument zur Prozesserfassung, -analyse und -optimierung zur Verfügung.

Das **Messboard REFLOW V6** besitzt acht Thermoelemente der höchsten Genauigkeitsklasse. Diese sind dauerhaft auf speziell ausgelegten Messfeldern platziert. Das **Messboard REFLOW V6** dient der Überprüfung der Anlagenparameter sowie ihrer Optimierung in der Lötanlage.

Das **horus®-Shuttle** ist für das **Messboard REFLOW V6** konzipiert und realisiert den thermischen Schutz für die **horus®-Elektronik**. Eine variable Anpassung der Transportbreiten erfolgt durch die mitgelieferten Extender. horus® sendet in Echtzeit die gemessenen Temperaturwerte mit dem Übertragungsstandard WIFI.

Dazu ist keine Internetverbindung notwendig. **horus®** ist für die Weichlötprozesse Reflow-Konvektion, Wellen- und Selektivlöt optimal ausgelegt. Die ausschließliche Verwendung von Standardschnittstellen ermöglicht dabei höchste Flexibilität. Ein eingebauter NiMH-Akku sorgt für mindestens zwei Stunden Dauerbetrieb und benötigt durchschnittlich 45 Minuten zum Aufladen. Die integrierte Akkuladestandsanzeige sowie die Überwachung der Elektronik-Innentemperatur gewährleistet höchste Sicherheit und einen unterbrechungsfreien Betrieb.

Die **horus®-Software** liefert herausragende Lösungen zu Parameterberechnung, Prozessauswertung, Profilvergleich und Dokumentation. Darüber hinaus sorgt sie für eine physikalisch korrekte Profilloptimierung nach nur einer Messung.

➔ Messboard REFLOW V6

- Erfassung des Querprofils und der Gradienten über die gesamte Transportlänge und -breite
- Messung der thermischen Zonentrennung sowie der Atmosphärentemperatur
- Erfassung des Gesamt-Energieeintrages der Anlage als Basis zur Beurteilung der Prozessfähigkeit einer Flachbaugruppe und Vergleich der unterschiedlichen Lötanlagen

TECHNISCHE HIGHLIGHTS

- > Intelligente WIFI-Verbindung ermöglicht eine Datenübertragung und Darstellung in Echtzeit
- > 8 Messkanäle mit 24 bit Auflösung
- > Messintervall ab 100 ms; Messzeit bis zu 35 min
- > Innentemperaturkontrolle und 3fach-integrierter Thermoschutz
- > Elektronik: RoHS-konform mit USB-C Schnittstelle und Miniatur-Thermosteckverbinder
- > Frei editierbare Protokolle mit Profil-, Gradienten- und Baugruppengrafiken
- > Automatische Profilbewertung
- > Präzise Profilverhersage nach nur einer Messung!
- > Kostenlose Software-Updates
- > Hochpräzise interpolierende 7-Punkt-Kalibrierung
- > Modernes Powermanagement mit NiMH-Akku und Ladezustandsanzeige in Echtzeit über Funk sowie Innentemperaturanzeige

TEMPERATURMESSUNG

Messbereich	- 140 bis 795 °C
Messgenauigkeit	±0,5 °C
Auflösung	0,1 °C
Messintervall	0,1 s
Messkanäle	8 Kanäle für Ni/CrNi

AUFNAHME FÜR WÄRMESCHUTZBOX

Länge	224 mm
Breite	101 mm
Breitenverstellbar bis	310 mm
Höhe über Stiftkette	25 mm

ABMESSUNGEN WÄRMESCHUTZBOX

Länge	211 mm
Breite	101 mm
Höhe	30-33 mm

ABMESSUNGEN MESSBOARDS

OGP-RE-2544	Länge	434 mm
	Breite	250 mm
	Höhe	14 mm
OGP-RE-5044	Länge	434 mm
	Breite	500 mm
	Höhe	14 mm

ABMESSUNGEN HORUS®-ELEKTRONIKSENDER

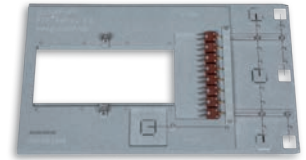
Länge	86 mm
Breite	82 mm
Höhe	23 mm

WEITERE DIENSTLEISTUNGEN

- Kundenspezifische Messboards
- Kundenspezifische Software-Features

BESTELLDATEN

- > OGP-RE-2544 bzw. OGP-RE-5044



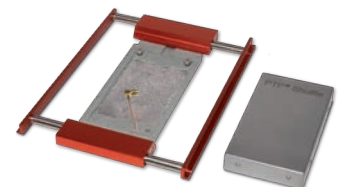
1 x Messboard REFLOW V6 mit 8 Thermoelementen Ni/CrNi

- > OGP-ME-V2



1x horus®-Elektronik + Software
1x Kalibrierung horus®-Elektronik (inkl. Zertifikat mit DKD-Referenz)
1x Aluminiumkoffer mit Einlage für Elektronik und Shuttle

- > OGP-SH002



1x horus® Shuttle, E-Träger und Thermoschutz